

第55回エンジニアリングセラミックスセミナー

「エンジニアリングセラミックスの塑性変形・破壊の最新動向」

近年、先進セラミックス材料における塑性変形や破壊などの力学・機械特性について新たな現象が数多く報告されています。また、その変形ならびに破壊挙動の計測ならびに解析技術が目覚ましい発展を遂げ、これまでに知られていないさまざまな知見が得られています。本セミナーでは、エンジニアリングセラミックスの塑性変形・破壊に関する研究・開発に携わられる気鋭の先生方をお招きし、当該分野の最新動向、また今後の展望についてご講演いただきます。

主 催：日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会
協 賛：日本化学会、日本金属学会、耐火物技術協会、粉体粉末冶金協会、粉体工学会、日本ファインセラミックス協会（予定）

開催日時：2024年12月13日（金）13:30～

場 所：東京大学（本郷キャンパス）山上会館 大会議室

URL：https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/society/facilities/b07_11.html

定 員：100名

参 加 費：会員 13,000円（協賛学協会含む）、学生会員 6,000円、非会員 15,000円
（申込時入会は会員扱）（消費税・テキスト代込）

申込方法：HP（https://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_j.html）の申込フォームよりお申し込みください。参加費はセミナー前日までに銀行振込にてご送金ください。お申込後の取り消しによる返金はいたしません。

問合せ先：〒169-0073 東京都新宿区百人町2-22-17

公益社団法人日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会

Email：encera [at] cersj.org（[at]部分を@に変えて下さい。）

振 込 先：三菱UFJ銀行千里中央支店（普）0073211

（公社）日本セラミックス協会エンジニアリングセラミックス部会 名義
銀行振込の振込受領書を領収書にかえさせていただきます

【プログラム】

13:30-13:35 開会挨拶

部会長（一財）ファインセラミックスセンター 北岡 諭

13:35-14:15 「微細組織に基づくジルコニアセラミックスの破壊靱性の大幅な向上」

東ソー(株)・東京大学 松井光二

14:15-14:55 「CMC 材料の高温疲労破壊におけるき裂進展挙動」

IHI Americas Inc. 金澤真吾

休憩

15:20-16:00 「微小領域における酸化物セラミックスの室温塑性変形」

東京大学 増田紘士

16:00-16:40 「ナノぜい性材料における微視的観点からの破壊力学評価と破壊メカニズム」

京都大学 嶋田隆広

16:40-17:20 「無機材料における塑性変形と可視光との相互作用」

大阪大学 中村篤智

17:20 閉会挨拶

副部会長 京セラ(株) 織田武廣